31.05.2023.

**Noslēdzies forums ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītām skolām**

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30 skolas un interešu izglītības iestādes ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros šā gada 22. maijā piedalījās forumā “Inovētspēja, transformācija, koprade nākotnes izaugsmei’’, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centru.

Foruma dalībniekiem bija iespēja gūt plašāku redzējumu par inovētspēju, dizaina domāšanu, domāt un runāt par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kā arī par plašākas skolēnu pieredzes nodrošināšanu, nepieciešamajām prasmēm nākotnē. RTU koprades telpās skolas varēja gūt praktiskus padomus par inovatīvām pieejām un stratēģijām izmantošanu STEM un vides mācību satura jomā ikdienas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs.

Foruma dalībnieki atzina, ka dalība forumā un praktiskās nodarbībās gūtā pieredze un atziņas radīja lielāku pārliecību par skolotāju gatavību inovācijām un sadarbībai, aprobējot jauniegūto pieredzi un  domājot par veiksmīgākās pieredzes ieviešanu.

Forumā, iedrošinot pārējos “skatīties pāri apvārsnim”, ar pieredzi dalījās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Rīgas pašvaldības skolas: Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Valdorfskola, Rīgas 10. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola, Rīgas 64. vidusskola un Rīgas 84. vidusskola.

[Foto galerija šeit](https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/galerija/foto-galerija/nosledzies-forums-esf-projekta-atbalsts-izglitojamo-individualo-kompetencu-attistibai-iesaistitam-skolam-602) (Autors: SIA „SIA Beyond UX”)

[Forums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=PtZJ9DsJpHw&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.visc.gov.lv%2F&source_ve_path=OTY3MTQ)

Forums tika organizēts ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

